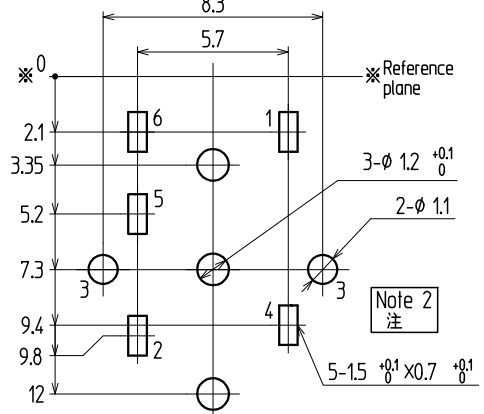
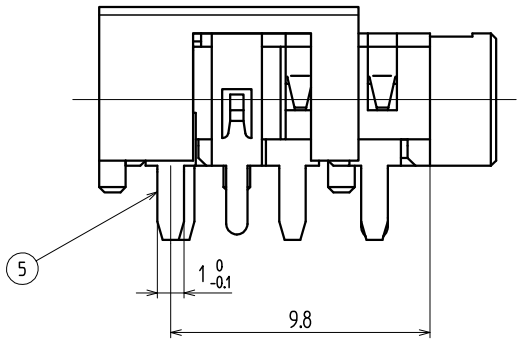
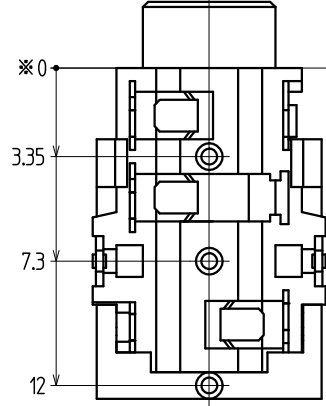
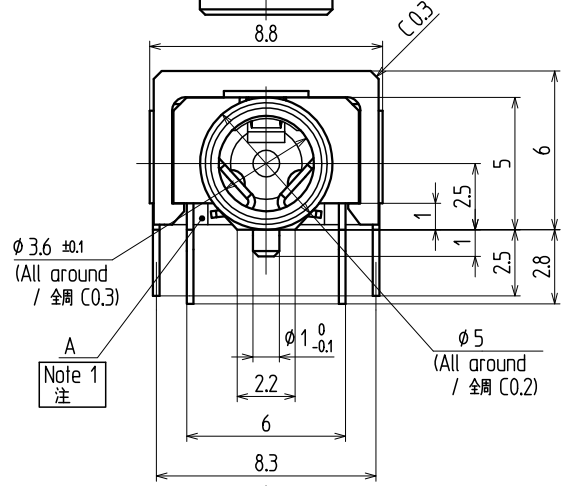
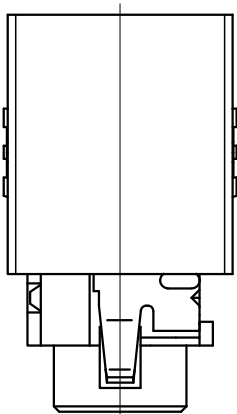


Circuit 回路図



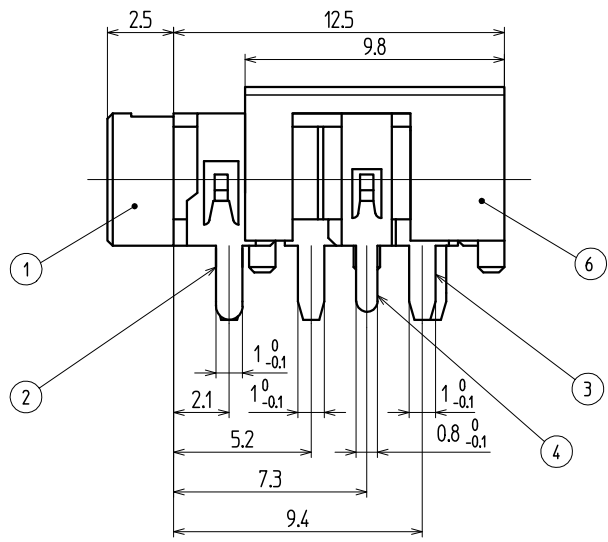
Dimensions of PC board holes 参考基板孔寸法図

(Tolerance All±0.1) (Printed side-view) 公差 ±0.1 (印刷面側) 11.2



Notes / 注記

1. Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.  
半田ゴテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様にご注意ください。
2. In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side and make sure that there is no solder on the component surface.  
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事、部品面に半田上がりが無いことを十分に確認して下さい。
3. Use a jig tool to fix the jack to a PCB so that it would not suspend from the PCB when you dip the jack in to a soldering bath.  
半田槽にてディップをする場合は、治具等を用いてジャックの浮きが生じないようにして下さい。
4. When soldering in auto soldering bath, it is suggested to check contact failure, appearance failurer etc, by flux before.  
自動半田槽にて半田付けを行う際には、事前にフラックス流入による接触不良、外観不良等の確認をお願いします。



With cover type  
カバー付タイプ  
3.5 DIA LA7

No.	PARTS NAME	QTY	MATERIAL	No.	UL	FINISH	REMARKS
品番	名称	個数	材質			処理	備考
6	COVER カバー	1	PBT GF15% WHITE 白		94V-0		
5	MAKE CONTACT メークパネ	1	BRASS 黄銅	t0.25 (M)		GOLD PLATED Auめっき	
4	TRANSFER CONTACT トランスファパネ	1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25 (TC)		GOLD PLATED Auめっき	
3	CONTACT コンタクト	3	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25 (T, R1, R2)		SILVER PLATED Agめっき	
2	EARTH CONTACT アースパネ	1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25 (S)		SILVER PLATED Agめっき	
1	HOUSING ハウジング	1	PA66 BLACK 黒		94V-0		

ALL DIMENSIONS ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( )印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者
--------------	-------------	-----------	--------------

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

TITLE 名称	3.5 DIA PHONE JACK 小形単頭ジャック	
CODE No. コードNo.	YKB21-5349	
UNIT 単位	mm	
SCALE 尺度	5/1	

TOLERANCE 寸法公差			
6 under 未満	± 0.3	X	
over 以上 6	± 0.4	X	
over 以上 20	± 0.5	X	
over 以上	±	X	
ANGLE(DEG) 角度	± 0°	MARK 記号	

REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当
----------------	---------	---------